

檔 號：
保存年限：

經濟部智慧財產局 審查意見通知函

機關地址：臺北市大安區辛亥路 2
段 185 號 3 樓

聯絡人：涂公遠

聯絡電話：(02)23767371

電子郵件：

傳 真：(02)23779875

受文者：大陸商西安奕斯偉材料科技股份
有限公司（代理人：張耀暉 專
利師、莊志強 專利代理人）

發文日期：中華民國 114 年 7 月 2 日
（114）智專二（物）04429 字第
發文字號：11420698020 號 
速 別：速件 *11420698020*
密等及解密條件或保密期限：
附 件：如文

主旨：第113149253號專利申請案經審查有說明一所述情事，請
於文到次日起3個月內提出申復說明或修正。屆期未申復
說明或修正者，依專利法第46條第2項規定將不予專利，
請查照。

說明：

一、本案經審查認為：

（一）本案「一種晶圓及其缺陷的偵測方法」，依申請人申請
時所提摘要、說明書、申請專利範圍及圖式進行審查，
經查本案申請專利範圍共10項，其中第1、8~9項為獨立
項，其餘為附屬項。

（二）本案申請專利範圍第8~9項，不符合專利法第26條第4項
暨其施行細則第18條第2項之規定；本案申請專利範圍
第2、5~6項，不符合專利法第26條第2項之規定。

1、本案請求項8~9標的名稱為一種晶圓，標的名稱不明
確（應敘明是何種晶圓，例如偵測無缺陷晶圓或是更

適格貼近原請求項之技術內容之標的)，不符合專利法第26條第4項暨其施行細則第18條第2項之規定。

2、請求項2，所載「…通過『紅外線雷射散射層析方式』按照設定的…」，雙引號內容是否與請求項1記載「紅外線雷射散射層析方式」為相同技術構件？請檢視及釐清關係；另請求項5~6亦有相同情形發生，不符合專利法第26條第2項之規定。

3、請求項5，所載「…的『待測晶圓』的中心開始至沿所述待測晶圓半徑…」，雙引號內容是否與請求項1記載「待測晶圓」為相同技術構件？請檢視及釐清關係；另請求項6亦有相同情形發生，不符合專利法第26條第2項之規定。

(三)本案除上述理由以外之請求項1、3~4、7、10發明，於現在時點並未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再通知不予專利理由。

二、本案如有修正、訂正，應依專利法第43條、第44條第3項、專利法施行細則第36條至第38條之規定辦理，並請依專利修正申請書、專利誤譯訂正申請書之規定撰寫。

三、若需當面示範或說明者，請以「面詢申請書」敘明面詢所依據之版本、面詢事項及說明並繳交規費新台幣1千元，本局認為有必要時，將另行通知面詢地點及時間。

四、檢送本案檢索報告1份。本案檢索報告如附有引證用之非專利文獻，僅供專利申請人個人參考之用，如涉及其他利用該著作之行為(如：列印紙本對公眾散布、將檔案上傳網路等)，仍應取得著作財產權人之同意或授權，以避免侵權。

正本：大陸商西安奕斯偉材料科技股份有限公司（代理人：張耀暉 專利師、莊志強
專利代理人）

副本：

第113149253號專利申請案檢索報告

1. 申請日： 113年12月18日		
2. 優先權日： 2024年6月25日		
3. 本案國際專利分類號(IPC)： G01N 21/88 (2006.01), G01N 21/94 (2006.01), C30B 15/04 (2006.01) C30B 29/06 (2006.01)		
4. 檢索國際專利分類號(IPC)範圍： G01N, C30B		
5. 檢索使用資料庫名稱： 全球專利檢索系統(GPSS)		
關聯性代碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯請求項
A	1. TW 202001234 A 2020/01/16 全文	1~10
A	2. TW 202119517 A 2021/05/16 全文	1~10
A	3. US 2020/0333262 A1 2020/10/22 全文	1~10
A	4. US 2020/0149188 A1 2020/05/14 全文	1~10
A	5. US 2019/0257001 A1 2019/08/22 全文	1~10
關聯性代碼說明： X：單獨引用即足以否定發明新穎性或進步性之特別相關的文獻。 Y：結合一或多篇其他文獻後足以否定發明進步性之特別相關的文獻。 A：一般技術水準之參考文獻。 D：說明書已記載之文獻。 E：申請在前、公開／公告在後之專利文獻。 O：公開使用、販賣或展覽陳列之文件。 P：申請日與優先權日間公開之文獻。 L：其他理由引用之文獻。		

完成日： 114年5月25日

11440793510

11420698020

第113149253號發明專利申請案檢索報告引證參考資料

1. TW 202001234 A

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpss3/gpsskmc/gpssbkm?!FRURLTW202001234>

2. TW 202119517 A

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpss3/gpsskmc/gpssbkm?!FRURLTW202119517>

3. US 2020/0333262 A1

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpss3/gpsskmc/gpssbkm?!FRURLUS2020/0333262>

4. US 2020/0149188 A1

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpss3/gpsskmc/gpssbkm?!FRURLUS2020/0149188>

5. US 2019/0257001 A1

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpss3/gpsskmc/gpssbkm?!FRURLUS2019/0257001>

備註：

這是一個由機器自動產生的檔案，以上所附的引證網址僅供參考。網址若有無法取得、錯誤或失效情形時，申請人可於全球專利檢索系統(GPSS)或其它檢索資料庫另行取得引證文獻。

GPSS網址 <https://tiponet.tipo.gov.tw/gpss/>